

1-5-3-5 導電ペーストジャンパ突起／导电膏跨线的凸出 / Projected conductive paste jumper

【特徴】 導電ペーストジャンパ回路が部分的に太っている状態の欠陥

【特征】 导电膏跨线的局部肥大的缺陷。

【Characteristics】 A conductive paste jumper is partially expanded.

【原因・判断ポイント・発生工程】 導電ペーストジャンパ印刷版の汚れ、印刷条件不適などにより出来たもの（導電ペーストジャンパ印刷工程）

【原因、判断要点、发生工序】 导电膏跨线的印刷版玷污、印刷条件不合适等而引起的（导电膏跨线印刷工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

A stained printing stencil for conductive paste jumpers or an improper printing condition causes the defect. (Conductive-paste jumper printing process)



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×

1-5-3-6 導体貼付突起／导线转移的凸出 / Adhered and projected conductor

【特徴】 配線板導体表面に、別の配線板から剥ぎ取られたような導体が付着している状態の突起

【特征】 导线表面附着从别的板件挤压出来的导线而凸出。

【Characteristics】 A conductor that appears to be torn off from another printed board and adheres to the conductor surface of the printed board.

【原因・判断ポイント・発生工程】 間紙を挟まずに配線板を高く重ねたため、自重による過度の負荷が加わり導体同士が圧着して、引き剥がす際に片側の配線板から引き剥がされた導体が転写残りにして出来たもの（回路形成後～レジスト塗布前工程）

【原因、判断要点、发生工序】 由于没有使用隔纸，板件的堆垛太高，自重过度的负荷致使导线之间互相挤压，当移开的时候，另一侧的导线被挤压所引起的（图形转移后～ET剂涂布前工序）。

【Causes/processes involved/keys to judgment】

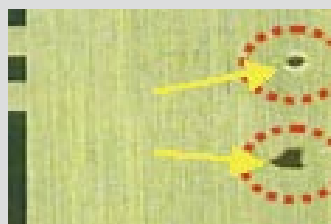
Many printed boards are stacked without using protection paper. Conductors are in contact each other because of the excessive load of their own. When the boards stacked together are separated, chips of conductor are torn off from one board and transferred to another board. (Conductor pattern etching – solder resist application)



【コメント】
右写真が突起不合格品、左写真は導体剥離後のピンホール、欠け写品

【注釋】
右照片是凸出不合格品，左照片是导线被挤压后的针孔、缺口。

【Comments】
Right photo shows reject product with projection. Left photo shows products having pinhole and nick caused by conductor tear off.



【コメント】
顕微鏡倍率 ×

【注釋】
显微镜倍率 ×

【Comments】
Magnification: ×